

mlcc失效分析，热值检测方法

产品名称	mlcc失效分析，热值检测方法
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

mlcc失效分析，热值检测方法

X-Ray检测，即为在不破坏芯片情况下，利用X射线透视元器件（多方向及角度可选），检测元器件的封装情况，如气泡、邦定线异常，晶粒尺寸，支架方向等。

适用情境：检查邦定有无异常、封装有无缺陷、确认晶粒尺寸及layout

优势：工期短，直观易分析

劣势：获得信息有限

局限性：

- 1、相同批次的器件，不同封装生产线的器件内部形状略微不同；
- 2、内部线路损伤或缺陷很难检查出来，必须通过功能测试及其他试验获得。

案例分析：

X-Ray 探伤----气泡、邦定线